

中微半导体设备（上海）股份有限公司董事会
关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划
和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的说明

中微半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买杭州众硅电子科技有限公司（以下简称“标的公司”）64.69%的股权（以下简称“标的资产”）并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

公司董事会经审慎判断，认为本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的相关规定，具体如下：

1、本次交易的标的资产为标的公司 64.69%的股权，该标的资产不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项；不涉及需取得相应的许可证书或者有关主管部门的批复文件。本次交易尚需提交公司股东会审议、获得上交所审核通过及中国证监会注册等。就本次交易中尚待履行的报批事项，公司已进行了披露，并对可能无法获得批准的风险作出了特别提示。本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条第（一）项的规定；

2、本次交易标的资产为标的公司 64.69%的股权，标的公司不存在出资不实或者影响其合法存续的情况。交易对方拥有的标的公司股权权属清晰，交易对方已合法拥有标的资产的完整权利，不存在限制或者禁止转让的情形。本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条第（二）项的规定；

3、本次交易有利于提高公司资产的完整性，有利于公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立性。本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条第（三）项的规定；

4、本次交易有利于公司改善财务状况、增强持续经营能力，有利于公司突出主业、增强抗风险能力，有利于公司增强独立性，不会导致新增重大不利影响的同业竞争，以及严重影响独立性或者显失公平的关联交易。本次交易符合《上

市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条第（四）项的规定。

特此说明。

中微半导体设备（上海）股份有限公司董事会

2026年3月30日